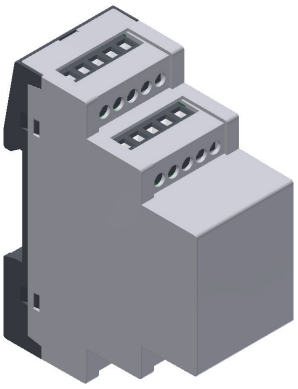
Isolierstoffgehäuse KU 4188

nach DIN 43 880 für Einbau in Verteilungen
70 mm Einbautiefe



Ihre Vorteile
- modular und flexibel
- maximale Platzverhältnisse
- variable Anschlusstechnik
- individuelle Anpassung nach Kundenwunsch möglich

Merkmale
- Breite 35 mm
- Nenntiefe 64 mm für Tiefenmaß max. 70 mm nach DIN 43880
- Gehäuseausführungen wahlweise
  - klemmenlos
  - mit Leiterplattenklemmen
  - mit steckbaren Schraubklemmen
  - mit steckbaren Federkraftklemmen
  - mit Kastenklemmen
  - mit verschiedenen Klemmen kombiniert
- geeignet zur Aufnahme von bis zu zwei waagrechten Leiterplatten mit Klemmen und zusätzlicher Leiterplatte für Display oder Bedienelemente in der Gehäusefront; wahlweise zur Aufnahme von bis zu 4 senkrechten Leiterplatten mit Klemmen
- Gehäuseöffnungen für Anschlussklemmen, Bedienelemente und Schnittstellen KNX und RJ45 auf Anfrage
- Bodenplatte wahlweise mit Seitenwänden zur Aufnahme von Leiterplattenbaugruppen

Technische Daten

Bestellbezeichnung:	Standard	UL
geschlossen:	0061102	0066501
Leiterplattenklemme:	0060120	0066503
steckbare Schraubklemme:	0060121	0066502
steckbare Federkraftklemme:		0066623
Kastenklemme:	0060292	0066504

Außenmaße: 35 x 90 x 71

Gehäusematerial
Haube: PC-GF, PC (UL) Lichtgrau RAL 7035
Bodenplatte: PC-GF, PC (UL) Tiefschwarz RAL 9005,
Klemmenblock: PC-GF, PA66/6 (UL)
Anschlussträger: PA66 (UL)

Temperaturbeständigkeit		PC-GF	(UL) PC	(UL) PA 66/6	(UL) PA 66
nach UL 746 B:		115 °C	115 °C	120 °C	150 °C
nach Vicat ISO 306	Meth. B:	145 °C	146 °C	230 °C	245 °C
nach ISO 75-2	(1,8 MPa):	136 °C	123 °C	225 °C	120 °C
	(0,45 MPa):	142 °C	142 °C	235 °C	231 °C

zulässige max. Verlustleistung: 7 W für freistehendes Gehäuse bei Normalklima 23/50-1 — ISO 554

spezifischer thermischer Widerstand: R_{th} = 15 K / W

Brennverhalten nach UL 94: Alle Gehäusematerialien: V-0
Ausnahme: PA66 (UL), strahlenvernetzt: HB

Anzahl der Klemmen: je 20 steckbare Klemmen und Leiterplattenklemmen; 16 Kastenklemmen; Minderbestückungen auf Anfrage

Gehäusebefestigung: Schnappbefestigung auf Hutschiene — EN 60 715

Kriechstromfestigkeit — IEC 60 112
PC-GF: CTI 175 ≙ Isolierstoff III a
PC: CTI 225 ≙ Isolierstoff III a
PA66/6: CTI 550 ≙ Isolierstoff II
PA66: CTI 600 ≙ Isolierstoff I

Schutzart: Gehäuseoberteil IP 40 — IEC 60 529
Bodenplatte IP 30
(Anschlussöffnungen IP 20)

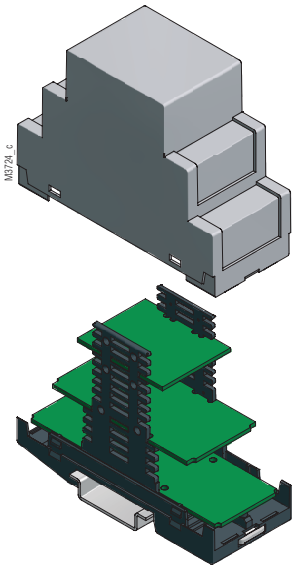
Beschriftungsfeld: 33,5 x 41,5 mm

Leiterplatte: siehe Leiterplattenzuschnitte
Leiterplattenhalterung, waagrecht: Schraubbefestigung an der Bodenplatte und / oder über die Seitenwände der Bodenplatte
Leiterplattenhalterung, senkrecht: Führungen in der Haube

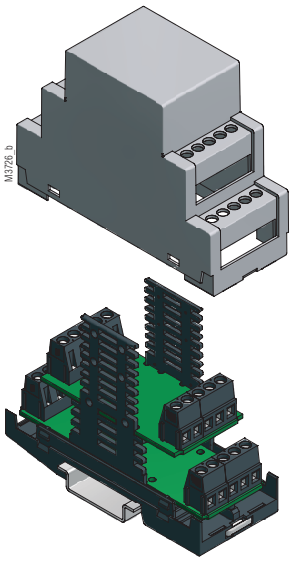
Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Klemmenübersicht G02

Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Ausgabe.
Technische Verbesserungen und Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.

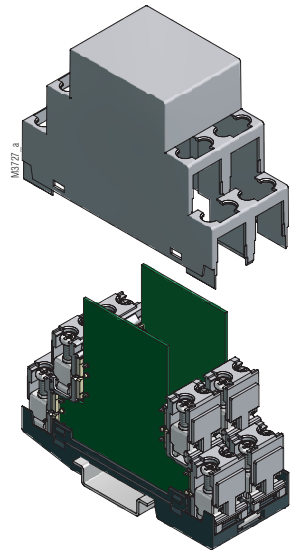
Explosionszeichnungen



geschlossen

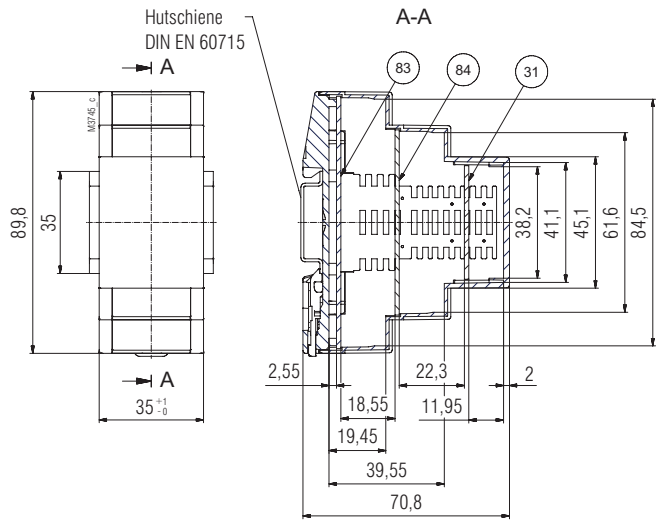


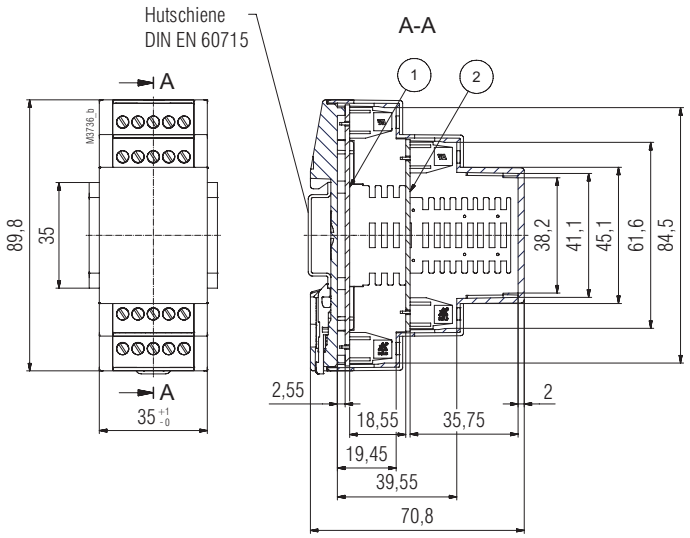
Leiterplattenklemme

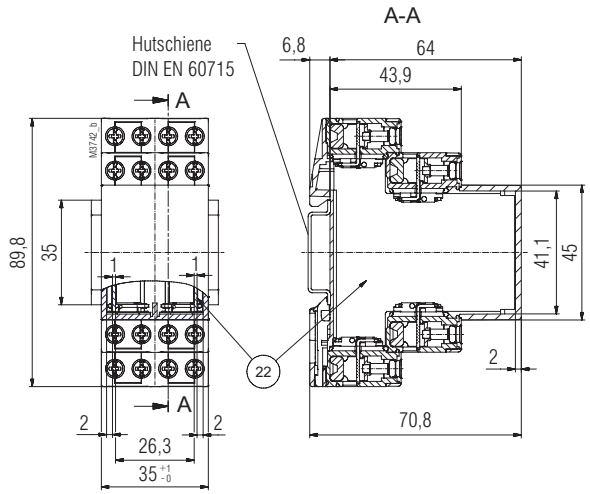


Kastenklemme

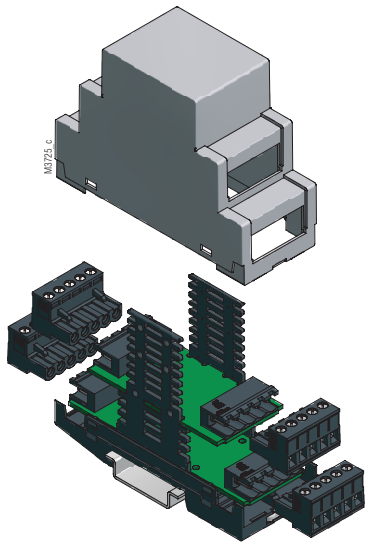
Maßbilder



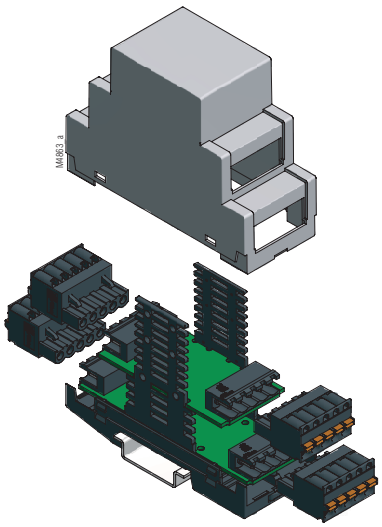




Explosionszeichnungen

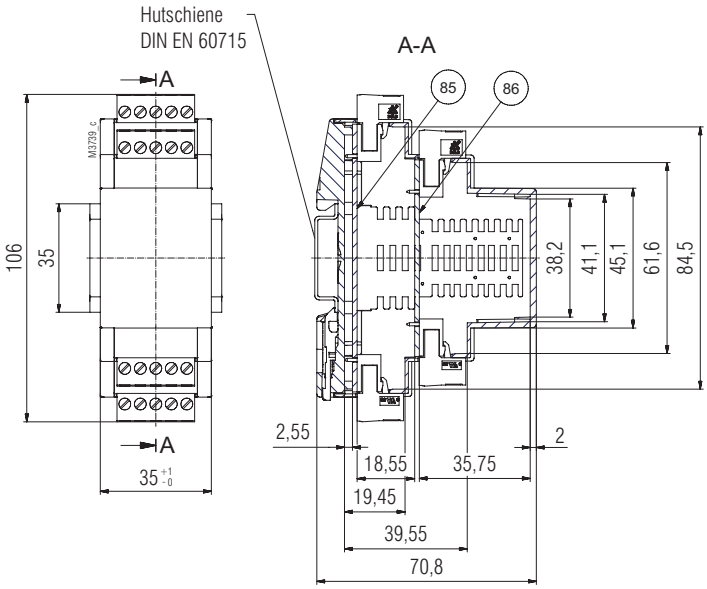


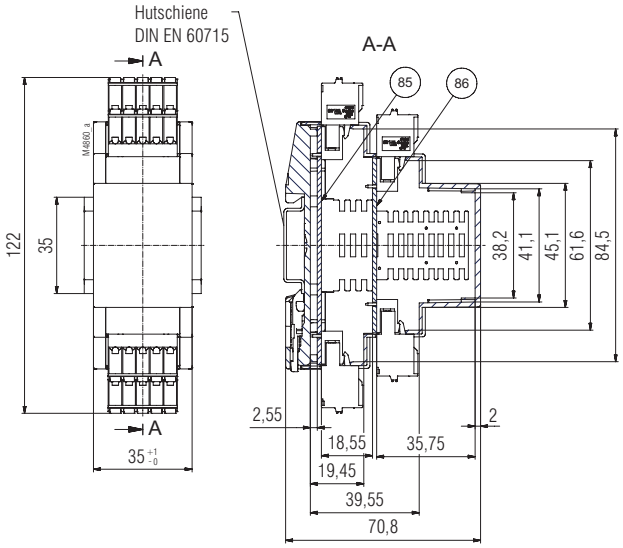
steckbare Schraubklemme



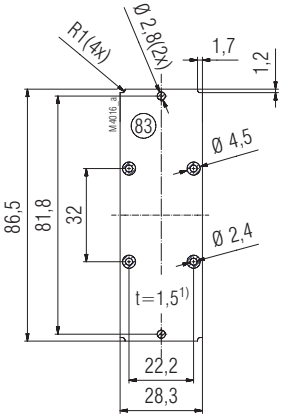
steckbare Federkraftklemme

Maßbilder

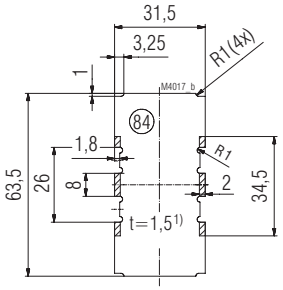




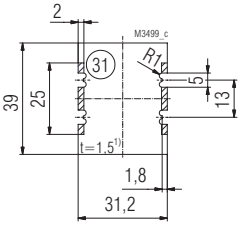
Leiterplattenzuschnitte



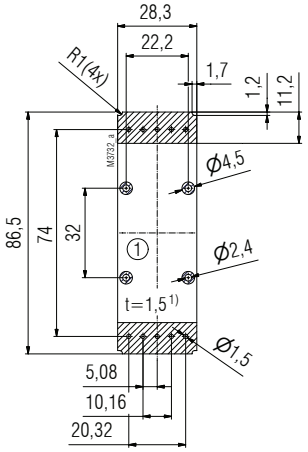
Leiterplatte in LP-Position Boden
für geschlossenes bzw.
aufgefrästes Gehäuse



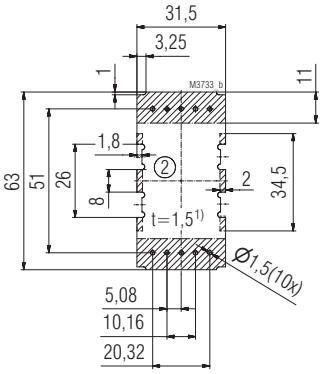
Leiterplatte in LP-Position Mitte
für geschlossenes bzw.
aufgefrästes Gehäuse



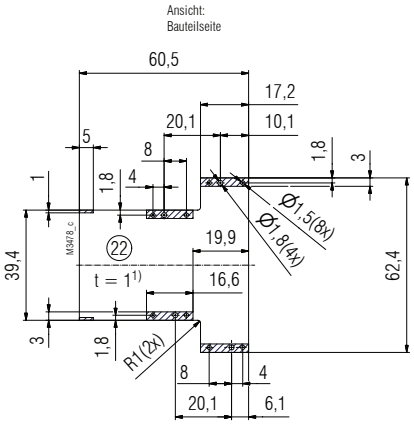
Leiterplatte in LP-Position Front
für geschlossenes bzw.
aufgefrästes Gehäuse



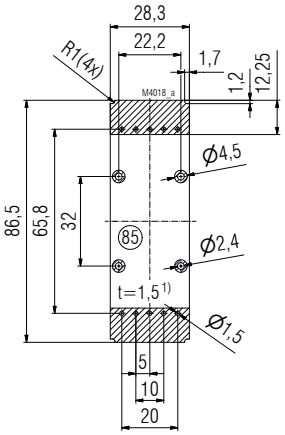
Leiterplatte in LP-Position Boden
für 2 x 5-polige Leiterplattenklemmen



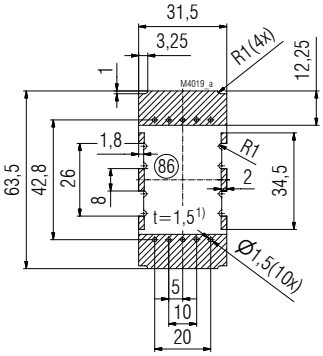
Leiterplatte in LP-Position Mitte
für 2 x 5-polige Leiterplattenklemmen



mit 4 x 2 poligen Kastenklemmen
RM 8,9 mm



Leiterplatte in LP-Position Boden
für 2 x 5-polige Stiftleisten
(steckbare Schraubklemmen bzw.
steckbare Federkraftklemmen)



Leiterplatte in LP-Position Mitte
für 2 x 5-polige Stiftleisten
(steckbare Schraubklemmen bzw.
steckbare Federkraftklemmen)

Sperrfläche

1) Toleranz nach DIN EN 60 249-2-4; Allgemeintoleranz: PERFAG 2 E

Löcher ø 2,4 bei Bedarf zum Anschrauben an die Bodenplatte mit Zylinderschrauben ISO 1207 M2x4